

Compression Molding System

Model CPM1080



**Compression molding system for high-quality and
low-cost WLP/PLP molding processes**

用于高质量和低成本的 WLP/PLP成形工艺的压缩成形设备

产品信息



中文

- 同款设备可同时对应颗粒及液态树脂
- 基于自主开发的压缩成形方式，实现晶圆级封装和面板级封装
- 在吐胶单元上配备了自动计量、自动补料功能
- 通过自制的搬运机器人，可对应较大翘曲或较重的载板搬送
- 分离膜采用预切割方式，每次成形分离膜的使用量节省约25%（相比本公司之前工艺）
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



Wafer type



Panel type

SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	CPM1080			
面板・晶圆类型		—	面板・晶圆			
设备区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
面板・晶圆尺寸	面板	mm	□320 (Max.)		□150—320	
	晶圆	mm	φ 320 (Max.)			
树脂		—	颗粒・液态			
机械时间		sec	—	—	Approximately 75	
外形尺寸	模组数量	module	1	1	1	2
	宽度	mm	1,388	2,950	3,910	4,590
	纵深	mm	1,650	2,010	2,180	2,180
	高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	4.4	6.3	7.0	10.6
每模成形晶圆数量		workpiece	1	1	1	2
料盒放置空间		—	—	—	FOUP Input / Output stage : 1 cassette each	
合模压力		kN／(tf)	98.0—784.0／10.0—80.0			
合模速度		mm／sec	100 (Max.)			
使用分离膜的宽度		mm	440 (Max.)			
自选	Chip count	—	—	—	○	○
	Package inspection	—	—	—	○	○
	Package thickness measurement	—	—	—	○	○
	After cure	—	—	—	○	○
	Dispenser	—	—	○	○	○

- ・ 以上数据为本公司标准机型时的规格
- ・ 当包含带有吐胶模组时，外部尺寸将增加680毫米
- ・ 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- ・ 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA MALAYSIA SALES
& SERVICES SDN. BHD.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250501-005-HQ